

半導体漫遊記

(267)

湯之上隆

経産省が5月31日、

「ポスト5G情報通信

システム基盤強化研究

開発事業」のうち、

「先端半導体製造技術

の開発」に関する実施

者の公募を行い、「高

性能コンピューティン

グ向け実装技術」の実

施者には「TSMCシ

ャパン3D IC研究開

発センター株式会社」

が選定されたことを発

表した。

これを受けて日経新

聞は6月16日、『半導

体再興「後工程」糸口

に』という記事で、T

SMCが日本に進出

し、半導体を積み重ね

る「3次元積層技術

(3D IC)」を、日

本の材料や装置メーカ

ー20社と共同で開発す

ることによって、日本

が半導体製造で復活す

る足掛かりになると報

道している。
ところが、最近ある

混乱が生じていた。

「TSMCジャパン3

DIC研究開発センタ

ー」に協力する20社の

リストに入っている企

業の多くは既に、この

分野でTSMC本社と

開発を進めている。従

って今更、日本で何を

開発するのだろうか

という疑問が湧くのであ

る。

一方、やはりTSMC

ずさん極まる経産省の半導体助成事業の発表

根拠確認せず報道も

有しているにもかかわらず、20社のリストに漏れている企業もある。そのような企業に

漏れている企業もある。そのような企業に

漏れている企業もある。そのような企業に

漏れている企業もある。そのような企業に

漏れている企業もある。そのような企業に

漏れている企業もある。そのような企業に

「TSMCジャパン3

DIC研究開発センタ

ー」に協力する20社の

リストに入っている企

業の多くは既に、この

分野でTSMC本社と

開発を進めている。従

ずさん極まる経産省の半導体助成事業の発表

根拠確認せず報道も

「TSMCジャパン3

DIC研究開発センタ

ー」に協力する20社の

リストに入っている企

業の多くは既に、この

分野でTSMC本社と

開発を進めている。従

って今更、日本で何を

開発するのだろうか

という疑問が湧くのであ

る。

一方、やはりTSMC

本社は2月9日に、3D

ICの日本での研究に

186億円を認可した

ことを公表したが、そ

れ以外は何も決まってい

ない」という。で

は、この経産省の発表

や日経新聞の記事は一

体何なんだ?

そこで、筆者は6月

28日に経産省に直接電

話し、「TSMCシ

ャ

ン3D IC研究開発セ

ンターは法人登記され

ている。その法人の電

話番号が秘密情報であ

るはずがない」と言い

返した。

結局6月28日は朝9

時から合計5回、経

産省に電話をかけた

り、疲労がピークに達

した19時半頃、やっと

電話番号を聞き出すこ

とに成功し、即効でT

SMCジャパン3D I

C研究開発センターに

電話して、その全貌を

解明するに至った。

企業	半導体関連の事業内容	株価の暴騰率
旭化成	表面保護などに使う各種材料	4.0
イビデン	先端パッケージ基板	9.3
JSR	感光材や研磨剤など	▲ 1.7
昭和電工マテリアルズ	樹脂封止材や研磨剤	5.3
信越化学工業	ウエハや封止材	▲ 2.0
新光電気工業	パッケージ基板やリードフレーム	4.8
住友化学	感光材やウエハ材料	2.0
積水化学工業	パッケージ基板製造用の材料	0.1
東京応化工業	感光材や接着剤などのプロセス材料	2.2
長瀬産業	接着・封止材や絶縁材料	0.8
日東電工	保護テープなどのプロセス材料	▲ 1.1
日本電気硝子	半導体向けのガラス基板	1.3
富士フイルム	感光材などのプロセス材料	2.4
三井化学	半導体製造用樹脂テープ	2.0
キーエンス	形状や位置の測定装置	0.7
芝浦メカトロニクス	先端向け組み立て機(ボンダー)	17.1
島津製作所	真空装置や各種分析機器	5.6
ディスコ	ダイサー	0.7
東レエンジニアリング	組み立て装置	5.8
日立ハイテク	各種の検査・測定装置	4.3

6月18日に日経新聞がTSMCジャパン3DIC研究開発センターに協力すると報じた20社

暴騰率は経産省が協力会社リストを公表した5月31日~6月11日までの増減率(%)

れから9月末にかけて表の何とずさんなことを期待させるような記事を報じた日経新聞も罪は重い。反省しろ! (微細加工研究所・所

しかし、経産省の発表、日本半導体の再興(長)